

主办方



赞助单位



sensors
an Open Access Journal by MDPI



Young Academic
亚昂学术会议

ICICM 2021

第六届集成电路与微系统国际会议

<http://icicm.net/>

征稿通知

中国南京

2021年10月22-24日

委员会

★大会顾问委员会主席

倪光南, 中国工程院院士

David Z. Pan, 德州大学奥斯汀分校 (IEEE Fellow, SPIE Fellow)

Ljiljana Trajkovic, 西门菲莎大学 (IEEE Fellow)

★大会顾问委员会委员

金石, 东南大学

孙立涛, 东南大学

洪伟, 东南大学

时龙兴, 东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心

★大会主席

王志功, 东南大学

李强, 电子科技大学

黄乐天, 电子科技大学

★大会联席主席

张在琛, 东南大学

杨军, 东南大学

徐申, 东南大学

马凯学, 天津大学

李丽, 南京大学

郭宇锋, 南京邮电大学

★程序委员会主席

张萌, 航天科工通信技术研究院

蔡志匡, 南京邮电大学

徐雷钧, 江苏大学

★程序委员会联席主席

张洵琳, 清华大学

邹卓, 复旦大学

★指导委员会主席

刘轶, 南京邮电大学

王科平, 天津大学

孟凡易, 天津大学

★本地主席

张萌, 东南大学

张竞扬, 东南大学

孙振华, 东南大学

王龙, 东南大学

★区域主席

徐宁, 武汉理工大学

杨晨, 西安交通大学

★出版主席

Ge Wang, 郑州轻工业大学

★宣传主席

唐建石, 清华大学

环宇翔, 复旦大学

论文集

本次会议收录并注册的文章将作为会议论文集出版并提交 Ei Compendex 和 Scopus 等知名数据库检索。

2016-2020 年的会议论文集已全被录入 IEEE Xplore 数据库, 并已被 EI 核心和 Scopus 数据库检索!

Scopus® Engineering Village

投稿主题

征稿主题包括但不限于以下内容:

- *数字、模拟、混合信号 IC 和 SOC 设计技术
- *硅集成电路与制造
- *低功率、射频设备和电路
- *集成电路计算机辅助设计技术
- *硅锗器件与器件物理
- *互连、低 K、高 K 等工艺技术
- *非常规和纳米电子学
- *有机半导体器件与技术
- *复合半导体器件和电路
- *显示器、传感器和 MEMS
- *半导体材料与材料特性
- *包装检测技术
- *太阳能电池及其他新能源设备
- *建模与仿真
- *设备技术
- *可靠性
- *显示器、传感器和 MEMS
- *高级存储技术 (闪存、FERAM、PCM、RERAM、MRAM 等)

会议投稿

投稿链接: <https://easychair.org/conferences/?conf=icicm2021>

文章模板: <http://icicm.net/files/Template.doc>

投稿截止: 2021年9月10日

联系方式

曾老师

邮箱: icicm@young.ac.cn

电话: 028-87777577



// 扫描微信二维码分配
会议管家获取快速回复 //